

★ 好評 第4回!自動車(EV/HEV)への適用に焦点をあて、小型化・高信頼性化を実現するパッケージ技術を解説!
★ 大電力・高耐圧を扱うパワー半導体の実装技術(接合・封止・絶縁・放熱技術)および信頼性技術を学びます!



自動車用に向けたパワー半導体におけるパッケージ技術 ～接合・接続・封止・高信頼性化・高耐熱化・高放熱化～ ＜パワー半導体パッケージコース＞



日時	2020年2月28日(金) 10:30～16:30	会場	東京・大田区平和島 東京流通センター 2F 第5会議室
受講料	49,500円 ⇒S&T会員 47,020円 ※S&T会員(郵送DM案内あるいはE-mail案内を希望される方)は価格が5%OFFになります。 (定価:本体45,000円+税4,500円 会員:本体42,750円+税4,270円)		資料・昼食付

講師 富士電機(株) 電子デバイス事業本部 開発統括部 パッケージ開発部 SiCモジュール課 主査 両角 朗 氏

紹介

【専門】

産業用・車載用パワー半導体モジュールの研究開発・設計に従事。現在、SiCモジュールの設計開発を担当。

趣旨

最新のパワーエレクトロニクスは、地球環境対策や電力消費削減対策に貢献する技術であり、我が国が世界をリードできる分野である。本セミナーでは、パワー半導体のパッケージ技術全般から、さらに自動車(EV/HEV)への適用に焦点をあて、小型化・高信頼性化を実現するパッケージ技術について詳細に述べる。また、次世代パワー半導体として注目されているSiCについても紹介する。

＜得られる知識・技術＞

大電力・高耐圧を扱うパワー半導体の実装技術(接合・封止・絶縁・放熱技術)および信頼性技術。
また、パワーエレクトロニクスと半導体の関係などの知識。

プログラム

1. パワーエレクトロニクスとパワー半導体
 - 1.1 パワーエレクトロニクスの重要性
 - 1.2 パワーエレクトロニクス機器の要求性能
 - 1.3 パワー半導体を取り巻く環境
2. パワー半導体モジュールの実装技術
 - 2.1 パワー半導体モジュールの構造と機能
 - 2.2 パワー半導体モジュールに対する要求性能
 - 2.3 WBG半導体の動向
3. パワー半導体モジュールのパッケージ技術
 - 3.1 接合技術
 - 3.2 接続技術

- 3.3 封止技術
- 3.4 絶縁技術
- 3.5 放熱技術
4. 信頼性
 - 4.1 モジュールの破壊メカニズム
 - 4.2 高信頼性化の取組み事例
5. まとめ

□質疑応答・名刺交換□

本セミナーは、3/16開催『SiCパワーデバイス』セミナーとのセット申し込みがございます。詳細は、弊社ホームページをご覧ください。

■2名同時申込みで1名分無料■
(1名あたり定価半額の24,750円)

※2名様ともS&T会員登録をしていただいた場合に限りです。 ※他の割引は併用できません。
※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。
※3名様以上のお申込みの場合、左記1名あたりの金額で受講できます。
※受講券、請求書は、代表者にご郵送いたします。
※請求書および領収書は1名様ごとに発行可能です。(通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。)

※講師、プログラムの内容が変更になる場合もございます。最新の情報はHPにてご確認ください。 ※申込用紙が複数枚必要な場合等は、本用紙をコピーしてお使いください。

セミナー申込用紙 B200278 (パワー半導体パッケージ)

会社名 団体名			
部署			
役職			〒
ふりがな	住所		
氏名			
TEL	FAX		
E-mail	※申込みに関する連絡に使用するため、可能な限りご記入ください。		

※太枠の中をご記入下さい。 ※□にチェックをご記入ください。
※E-mailアドレスまたはFAX番号を必ずご記入下さい。

今後のご案内	
<input type="checkbox"/> E-mail希望・登録済み	S&T会員価格を 適用いたします。 (E-mailアドレス必須)
<input type="checkbox"/> 郵送希望・登録済み	
<input type="checkbox"/> 希望しない	
お支払方法	
<input type="checkbox"/> 銀行振込 (振込予定日 月 日)	
<input type="checkbox"/> 当日現金払い	
通信欄	

●受講料について
「2名同時申込みで1名分無料」については上記の注意事項をお読みください。
●お申込みについて
申込用紙に必要事項をご記入のうえ、FAXでお申込みください。
また、当社ホームページからでもお申込みいただけます。
お申込みを確認次第、請求書・受講券・会場案内図をお送りします。
●お支払いについて
受講料は、銀行振込(原則として開催日まで)、
もしくは当日現金にてお支払いください。
銀行振込の場合、原則として領収書の発行はいたしません。
振込手数料はお客様がご負担ください。

●個人情報の取り扱いについて
ご記入いただいた個人情報は、
事務連絡・発送の他、情報案内等に使用いたします。
詳しくはホームページをご覧ください。
●キャンセル規定
開催日から逆算(営業日:土日・祝祭日等を除く)いたしまして、
・開催7日前以前のキャンセル: キャンセル料はいただきません。
・開催3～6日前でのキャンセル: 受講料の70%
・開催当日～2日前でのキャンセル・欠席: 受講料の100%
※ご注意※ 参加者が最少催行人数に達しない場合など、
事情により中止になる場合がございます。



サイエンス & テクノロジー
研究・技術・事業開発のためのセミナー/書籍
サイエンス&テクノロジー株式会社
TEL 03-5733-4188 FAX 03-5733-4187
〒105-0013
東京都港区浜松町1-2-12 浜松町F-1ビル7F
http://www.science-t.com

FAX 03-5733-4187

HPからも
お申込みができます

検索
サイトで

B200278 パワー半導体パッケージ で検索!